

. **Engicam** je talianska spoločnosť so sídlom vo Florencii. Spoločnosť bola založená v roku 2004 s cieľom poskytovať dizajnérske služby elektronických systémov s vysokým obsahom technológie, opierajúc sa o dlhoročné skúsenosti v oblasti elektronického dizajnu

Vďaka odborným znalostiam a uznávanej autorite úspešne rozvíja spoluprácu s kľúčovými OEM v spotrebiteľskej, automobilovej, námornej a železničnej oblasti, ako aj s malými a strednými spoločnosťami pôsobiacimi na priemyselnom trhu.

Neustále investície do výskumu a vývoja umožňujú spoločnosti Engicam poskytovať a vyvíjať stále výkonnejšie a efektívnejšie platformy.

Engicam pomáha zákazníkom počas celého procesu vývoja smerom k finálnemu systému, pričom poskytujeme hardvérovú a softvérovú podporu na vysokej úrovni od začiatku až po sériovú výrobu.

## SOM /System on module/ riešenia

Moduly Engicam sú navrhnuté tak, aby uľahčili mechanickú integráciu, pričom dbajú na minimalizáciu a modularitu rozmerového faktora. Extrémna flexibilita umožňuje vývoj rôznych produktov s použitím rovnakej základnej dosky umožňujúcej optimalizáciu nákladov. Všetky moduly majú zaručenú dlhodobú dostupnosť produktu a sú osvedčené v stovkách rôznych aplikácií v extrémne náročných tepelných a mechanických prevádzkových podmienkach. Engicam ako člen konzorcia SGET ponúka aj moduly založené na štandarde Qseven a SMARC.

- [SODIMM](#)



Označenie SODIMM je rada modulov implementovaných na konektore SODIMM-200 a založená na všeobecnej definícii pinov nazývaných EDIMM interfejs.

Toto riešenie ponúka značnú robustnosť v mnohých rôznych aplikáciách a v extrémne náročných tepelných a mechanických prevádzkových podmienkach, ako je automobilový a železničný priemysel.

- [Micro SOM](#)



Rodina Engicam MicroSOM je vybavená energeticky úsporným procesorom ARM NXP® a ST®, ponúka extrémne vysoký výkon, možnosti výpočtu v reálnom čase a prevádzku s nízkou spotrebou. Tieto SOM moduly sa dodávajú so širokou škálou periférnych zariadení pri zachovaní minimálnych rozmerov.

- [Standard](#)



- [UltraGEA](#)



**Engicam** predstavuje rodinu modulov založenú na výkonných procesoroch NXP® i.MX 8QM. Nové moduly sú určené pre aplikácie vyžadujúce značný výpočtový výkon.

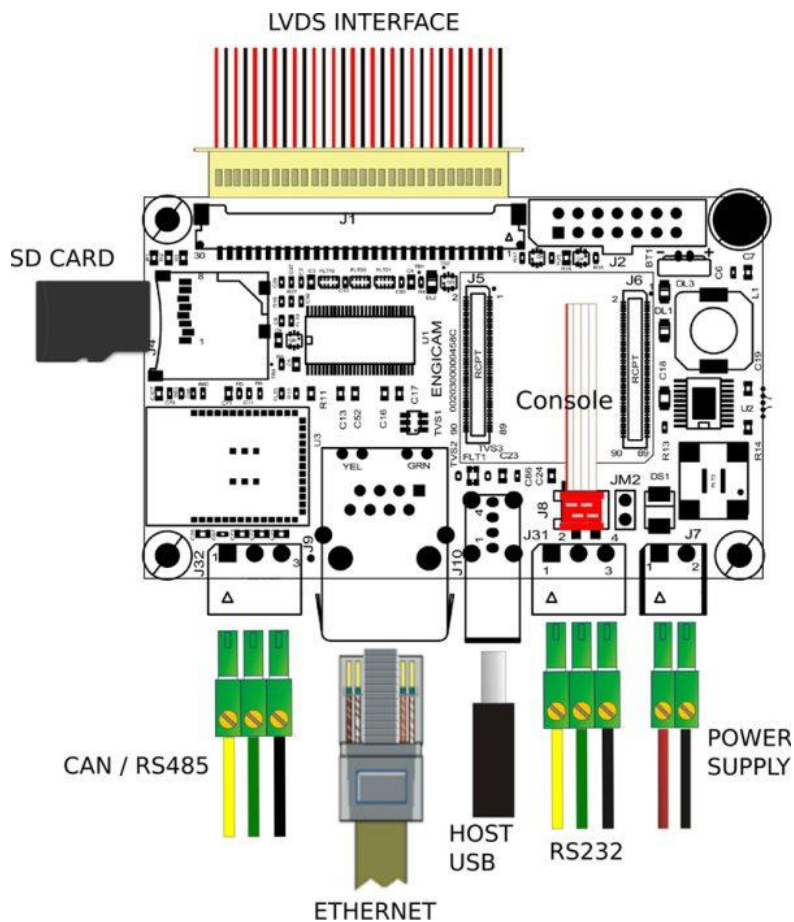


MicroDev 2.0 je mini-nosná doska založená na moduloch MicroGEA MX6ULL a MicroGEA STM32MP1.

Doska poskytuje v ultra kompaktnom priestore širokú škálu pripojovacích rozhraní, ako je zbernica CAN (dostupná na MicroGEA MX6ULL) a rozhranie UMTS LTE so SIM konektorom a WiFi + BT. Vstavané aplikácie sú vysoko modulárne, použitie modulov SOM umožňujú rôzne varianty architektúry a dizajnu.

Nosná doska MicroDev 2.0 so svojimi malými rozmermi a nízkou spotrebou energie je ideálna pre akýkoľvek projekt, ktorý vyžaduje maximálnu efektivitu na malom priestore.

K dispozícii je taktiež plastový box na transformáciu MicroDev 2.0 na extrémne kompaktnú IoT bránu.



[MicroGEO MX6ULL](#)

Tento modul MicroGEO je najmenší modul založený na i.MX 6ULL. Všetko je uzavreté v rozmeroch 25 × 25 mm s hrúbkou 3,5 mm. Procesor NXP i.MX 6ULL® dosahuje extrémne nízku spotrebu energie a je schopný ovládať LCD modul s rozlíšením až WXGA (1366 × 768).



[MicroGEO STM32MP1](#)

Modul MicroGEO STM32MP1 je založený na novom procesore STM32MP157 vybavenom dvojjadrovým Cortex-A7 @ 650 / 800 MHz a Cortex M4 @ 200 MHz. Zaručuje veľmi vysoký výkon v reálnom čase pri nízkej spotrebe energie. Široká škála podporovaných periférnych zariadení len s rozmermi 25 × 25 mm.

***Náš tím technikov Vám v spolupráci s výrobcom zabezpečí plnú podporu implementácie spomínaných modulov do Vašich aplikácií a projektov.***